2026-2031年中国电子布“十五五”产业链全景调研及投资环境深度剖析报告

报告简介

电子布又称电子级玻璃纤维布，是用电子级玻璃纤维纱经过经纬交织制成的薄型织物，经过表面处理后覆于树脂层压板之中，作为覆铜板与印制电路板的基础增强材料。它承担着维持板材结构强度、阻隔电气信号、稳定尺寸与耐热耐湿的作用，性能优劣直接影响电路板的平整度、耐温等级与信号传输可靠性。按纤维直径、布面厚度、织造方式与表面处理工艺区分，可对应不同层级的电路板使用需求，从普通消费电子板到高频高速、高密度互连电路板，都会匹配相应规格的电子布产品。本次调研以各类电子级玻纤布整机织物为核心观察对象，同步纳入配套的玻纤原纱、表面处理药剂、织造后整理工艺及相关应用服务板块，厘清电子布与普通工业玻纤布、电子纱之间的划分边界，划定统一研究范围，为全篇报告建立一致的参照基准。

随着各类电子终端与电路板设计不断更新，电子布的使用场景与采购规模持续扩大。早期电路板所用增强材料规格相对单一，后续随着设备向轻薄化、高频化发展，普通织物已难以满足板材在介电性能、耐温、尺寸稳定性方面的要求，更多细分规格的电子布陆续走向应用。使用主体涵盖覆铜板制造、电路板加工、通信设备、汽车电子、工业控制及消费电子等多个方向，不同方向对布面参数、耐温指标、介电表现的要求各有侧重。业务链条各环节衔接清晰，从玻璃原料配合、原纱拉丝、织布织造，到表面处理、成品检测与交付使用，各环节分工明确。参与经营的主体依托自身工艺与客户资源选定布局方向，市场评判产品的维度也日趋多元，除布面克重、纱支密度等基础指标外，批次一致性、缺陷控制、与树脂体系的适配程度、供货稳定性，都会成为采购方评估时的重点。

从产品走向看，低介电、低损耗、薄型化与精细化是后续优化的主要方向，面向高频高速通信、车载电子、高端计算设备的专用织物规格会不断丰富，织物与树脂、铜箔之间的协同适配水平持续提升。在政策层面，电子信息基础材料、高端新材料相关规划持续推进，相关主管部门围绕核心元器件配套材料补强、关键材料质量提升与自主化应用出台多项引导措施，鼓励企业完善工艺、提升高端规格产品的自给

能力，推动基础材料与下游电路板、终端制造之间形成更顺畅的配套衔接。规划方向明确了基础材料在电子信息制造体系中的位置，为相关产品的研发投入、产线改造与应用验证提供了政策环境。整体来看，工艺升级与政策引导相互配合，为行业内企业调整产品结构、切入更高附加值规格提供了外部条件。

《2026-2031年中国电子布“十五五”产业链全景调研及投资环境深度剖析报告》由中道泰和集团下属产业研究院的资深专家和研究人员通过周密的市场调研，参考国家统计局、政府部门机构发布的最新权威数据，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过相关市场研究的工具、理论和模型撰写而成。本报告总结了“十四五”以来经济与社会发展成就、产业发展规模与经济效益、预测了电子布行业规划方向机及未来5年行业投资方向;预测并提出了电子布“十五五”整体规划目标及方向、规划内容的建议等;最后，就电子布行业“十五五”时期投资机遇、投资风险、投资策略进行了审慎分析。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网以及国内外多种相关报刊杂志媒体提供的最新研究资料。本报告对国内外电子布行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对电子布下游行业的发展进行了探讨，是电子布及相关企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握电子布行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

本报告也可以用于专精特新、小巨人、单项冠军、行业地位证明，申请申报。

报告目录

第一章 电子布行业界定与发展范畴

第一节 行业基本概念

一、电子布是指

二、电子布与普通玻璃纤维布边界划分

三、电子布与覆铜板、印制电路板关系

四、行业技术属性与产业定位

第二节 行业分类体系

一、按厚度规格分类

二、按介电性能分类

三、按应用场景分类

四、按产品形态分类

第三节 行业发展阶段特征

一、从通用材料转向高端功能材料

二、从规模扩张转向结构升级

三、从进口依赖转向国产替代

四、从周期波动转向成长与周期并存

第二章 全球电子布市场发展回顾

第一节 全球市场规模与区域格局

一、全球市场规模变化

二、亚洲市场发展特征

三、北美市场发展特征

四、欧洲市场发展特征

第二节 全球细分市场竞争格局

一、普通电子布市场格局

二、低介电电子布市场格局

三、超薄与极薄电子布市场格局

四、石英电子布市场格局

第三节 全球技术与产业趋势

一、高频高速材料需求提升

二、超薄化与低损耗技术迭代

三、高端织造设备供给约束

四、全球供应链区域化调整

第三章 中国电子布行业发展环境

第一节 产业需求环境

一、算力基础设施建设需求增长

二、汽车电子化水平提升

三、通信设备升级带动需求

四、消费电子轻薄化趋势延续

第二节 技术与制造环境

一、电子级玻璃纤维纱供应能力提升

二、高端织造设备国产化进展

三、表面处理与后处理工艺完善

四、智能制造与质量控制能力增强

第三节 市场应用环境

一、覆铜板企业采购需求释放

二、印制电路板产业升级推进

三、先进封装与载板需求拓展

四、海外市场拓展空间打开

第四章 中国电子布产业链全景分析

第一节 产业链结构

一、上游电子纱与原料供应

二、中游电子布制造与加工

三、下游覆铜板与印制电路板应用

四、终端应用场景传导机制

第二节 上游环节分析

一、高纯石英砂与矿物原料供应

二、电子级玻璃纤维纱产能分布

三、浸润剂与表面处理剂配套

四、高端织造设备与关键部件供应

第三节 中游环节分析

一、电子布织造工艺路线

二、纱布一体化企业能力

三、专业织布企业分工格局

四、产能扩张与良率提升进展

第四节 下游环节分析

一、覆铜板企业需求结构

二、印制电路板企业采购特点

三、先进封装与载板配套需求

四、终端品牌客户认证体系

第五章 中国电子布市场运行分析

第一节 产业规模变化

一、电子布市场规模变化

二、电子纱产能与产量变化

三、不同规格产品规模变化

四、进出口规模变化

第二节 产品结构变化

一、普通布与高端布占比变化

二、超薄与极薄布占比提升

三、低介电布渗透率变化

四、石英布产业化进展

第三节 区域格局变化

一、重点产区分布

二、产业集群协同能力

三、区域客户需求差异

四、区域配套与物流协同进展

第四节 市场竞争变化

一、头部企业集中度提升

二、国内企业份额持续提升

三、高端产品竞争格局调整

四、中小企业出清与整合加速

第六章 电子布供需形势分析

第一节 供给能力分析

一、电子纱供给能力

二、电子布产能供给能力

三、高端产品供给能力

四、设备与良率约束情况

第二节 需求结构变化

一、算力硬件需求增长

二、汽车电子需求增长

三、通信设备需求增长

四、消费电子与工控需求变化

第三节 供需匹配状况

一、高端产品供需偏紧

二、中低端产品竞争充分

三、核心原料影响交付节奏

四、产品迭代与需求匹配变化

第七章 电子布核心技术发展分析

第一节 关键技术体系

一、电子纱拉丝与配方技术

二、精密织造与张力控制技术

三、表面处理与后处理技术

四、厚度控制与均匀性技术

第二节 技术突破方向

一、低介电常数材料突破

二、低热膨胀材料突破

三、超薄与极薄布良率提升

四、石英电子布产业化突破

第三节 技术创新趋势

一、高频高速材料持续迭代

二、智能制造与在线检测应用

三、绿色制造与能耗降低

四、材料、工艺与应用协同优化

第八章 电子布应用场景分析

第一节 算力硬件场景

一、ai服务器主板应用

二、高速交换机与路由器应用

三、光模块与高速互联应用

四、存储与先进封装应用

第二节 通信设备场景

一、5g基站承载应用

二、通信背板与天线应用

三、数据中心网络设备应用

四、卫星通信设备应用

第三节 汽车电子场景

一、动力控制系统应用

二、智能驾驶系统应用

三、车载域控制器应用

四、车灯与显示系统应用

第四节 消费电子与工业场景

一、智能手机与平板应用

二、可穿戴设备应用

三、工控设备应用

四、医疗与能源设备应用

第九章 电子布用户群体与需求分析

第一节 用户结构特征

一、覆铜板制造企业用户

二、印制电路板制造企业用户

三、封装基板与载板企业用户

四、终端品牌与系统集成用户

第二节 用户需求偏好

一、介电性能与信号完整性

二、尺寸稳定性与耐热性

三、供应稳定与交付能力

四、认证支持与技术服务能力

第三节 用户采购决策因素

一、产品性能与批次稳定性

二、价格与全生命周期成本

三、客户认证与供应链安全

四、本地化服务与协同开发能力

第十章 电子布商业模式分析

第一节 主要商业模式

一、电子纱与电子布一体化模式

二、专业织布加工模式

三、高端定制与联合开发模式

四、材料加技术服务模式

第二节 盈利模式演变

一、规模制造与成本优势

二、高端产品技术溢价

三、长协锁量与稳定收益

四、认证壁垒带来的客户粘性

第三节 商业模式创新趋势

一、从材料供应向解决方案延伸

二、从单一产品向纱布一体化延伸

三、从国内配套向全球供应链延伸

四、从周期销售向长期协同延伸

第十一章 中国电子布行业竞争格局分析

第一节 竞争主体类型

一、全球头部材料企业

二、国内综合玻纤企业

三、高端电子布专业企业

四、区域性织布与加工企业

第二节 市场竞争结构

一、普通电子布竞争格局

二、低介电电子布竞争格局

三、超薄与极薄布竞争格局

四、石英电子布竞争格局

第三节 行业进入壁垒

一、配方与工艺壁垒

二、设备与产能壁垒

三、客户认证壁垒

四、资金与良率壁垒

第十二章 电子布重点企业分析

第一节 全球头部企业

一、企业发展概况

二、产品与技术布局

三、市场表现特点

四、竞争优势与发展动向

第二节 国内综合玻纤企业

一、企业发展概况

二、电子纱与电子布能力

三、产能与客户布局

四、竞争优势与发展动向

第三节 高端电子布专业企业

一、企业发展概况

二、核心产品能力

三、重点客户与认证进展

四、竞争优势与发展动向

第四节 区域性与潜力企业

一、企业发展概况

二、制造与服务能力

三、客户结构特点

四、竞争优势与发展动向

第十三章 中国电子布市场需求预测

第一节 需求驱动因素

一、算力基础设施持续投入

二、印制电路板升级加速

三、汽车电子化需求深化

四、海外市场拓展空间扩大

第二节 分场景需求预测

一、算力硬件场景需求预测

二、通信设备场景需求预测

三、汽车电子场景需求预测

四、消费电子与工业场景需求预测

第三节 分产品类型需求预测

一、普通电子布需求趋势

二、低介电电子布需求趋势

三、超薄与极薄布需求趋势

四、石英电子布需求趋势

第十四章 中国电子布行业供给预测

第一节 供给趋势

一、高端产品供给能力增强

二、纱布一体化比例提升

三、高端设备与良率改善

四、运维与服务体系完善

第二节 区域供给趋势

一、制造资源向优势区域集聚

二、核心产区研发能力强化

三、区域配套协同增强

四、海外交付与本地服务能力提升

第三节 企业能力趋势

一、从材料制造向解决方案升级

二、从通用产品向高端产品升级

三、从国内竞争向全球竞争升级

四、从价格竞争向价值竞争升级

第十五章 电子布行业发展趋势

第一节 技术发展趋势

一、介电性能持续优化

二、超薄化与高密度织造推进

三、低热膨胀与高可靠性增强

四、绿色制造与智能工厂建设

第二节 产品发展趋势

一、高端产品占比提高

二、定制化产品扩展

三、材料与服务价值提升

四、跨场景适配能力增强

第三节 市场发展趋势

一、头部企业优势继续强化

二、国内企业份额稳步提升

三、高端产品竞争加剧

四、海外市场成为重要增长方向

第四节 产业生态趋势

一、电子纱、电子布与覆铜板协同深化

二、材料与印制电路板联动增强

三、终端客户联合开发加强

四、供应链稳定性与本地化能力提升

第十六章 电子布行业投资机会分析

第一节 投资热点领域

一、高端电子布品牌企业

二、低介电与低热膨胀材料方向

三、电子纱与关键原料环节

四、算力硬件与先进封装配套方案

第二节 重点投资方向

一、具备纱布一体化能力企业

二、拥有高端认证与客户资源企业

三、深耕算力与汽车电子场景企业

四、具备海外渠道与服务能力企业

第三节 投资风险因素

一、下游需求波动风险

二、原料与设备供给风险

三、同质化竞争与价格压力风险

四、技术迭代与认证周期风险

第十七章 电子布行业投资策略与建议

第一节 企业发展策略

一、强化高端产品与认证能力

二、优化电子纱与电子布协同布局

三、深化算力与汽车电子场景合作

四、完善服务、软件与海外渠道

第二节 投资者策略建议

一、关注具备认证壁垒的头部企业

二、关注低介电、低热膨胀与石英布方向

三、关注算力硬件与先进封装增长机会

四、关注供应链稳定与现金流稳健企业

第三节 行业发展建议

一、提升高端电子纱与关键原料配套能力

二、推动高端织造设备与工艺国产化

三、加强场景化产品与联合开发能力

四、优化国内国际双循环市场布局

第十八章 “十四五”总结与“十五五”规划方向

第一节 “十四五”期间发展成就

一、产业规模稳步扩大

二、产品结构持续优化

三、国产替代取得进展

四、产业链协同能力增强

第二节 “十四五”期间主要问题

一、高端产品供给仍显不足

二、关键设备与原料存在约束

三、认证周期长影响市场拓展

四、区域发展不均衡仍然存在

第三节 “十五五”期间发展方向

一、加快高端电子布国产化突破

二、提升算力与先进封装配套能力

三、推动绿色制造与智能制造升级

四、增强全球供应链竞争力

第四节 “十五五”期间规划建议

一、完善关键材料与设备支撑体系

二、建设共性技术研发与检测平台

三、推动产业链上下游协同创新

四、优化投资布局与风险防范机制

图表目录

图表：电子布行业分类体系

图表：电子布与普通玻璃纤维布边界示意

图表：电子布与覆铜板、印制电路板关系示意

图表：电子布产业链全景结构

图表：电子布产业价值链分布

图表：全球电子布市场规模与区域分布

图表：全球主要地区电子布发展路径比较

图表：国际电子布品牌竞争格局演变

图表：全球普通电子布市场结构

图表：全球低介电电子布市场结构

图表：全球超薄与极薄电子布市场结构

图表：全球石英电子布市场结构

图表：中国电子布上游供应结构

图表：中国电子布中游制造能力分布

图表：中国电子布下游应用场景分布

图表：2021-2025年中国电子布市场规模变化

图表：2021-2025年中国电子纱产能与产量变化

图表：2021-2025年中国不同规格电子布规模变化

图表：2021-2025年中国电子布进出口规模变化

图表：中国电子布产品结构变化

图表：中国电子布区域分布格局

图表：中国重点产区电子布渠道布局

图表：中国电子布供给能力变化

图表：中国电子布需求结构变化

图表：中国电子布供需匹配状况

图表：算力硬件电子布应用结构

图表：通信设备电子布应用结构

图表：汽车电子电子布应用结构

图表：消费电子与工业电子布应用结构

图表：电子布用户结构分布

图表：电子布用户采购决策因素分布

图表：电子布主要商业模式对比

图表：电子布盈利模式演变路径

图表：中国电子布行业竞争梯队结构

图表：普通电子布竞争格局

图表：低介电电子布竞争格局

图表：超薄与极薄电子布竞争格局

图表：石英电子布竞争格局

图表：中国电子布行业进入壁垒分析

图表：2026-2031年中国电子布市场规模预测

图表：2026-2031年中国算力硬件电子布需求预测

图表：2026-2031年中国汽车电子电子布需求预测

图表：2026-2031年中国高端电子布需求预测

图表：2026-2031年中国电子布产品结构预测

图表：2026-2031年中国电子布区域供给趋势

图表：2026-2031年中国电子布技术发展趋势

图表：中国电子布行业主要风险因素分析

图表：中国电子布企业战略发展路径建议

图表：“十四五”期间中国电子布产业发展成就总结

图表：“十五五”期间中国电子布行业发展方向建议

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费)　Emai：kf@51baogao.cn

报告编号：4070544

本文地址：https://www.51baogao.cn/baogao/20261115/4070544.shtml

在线订购：点击这里